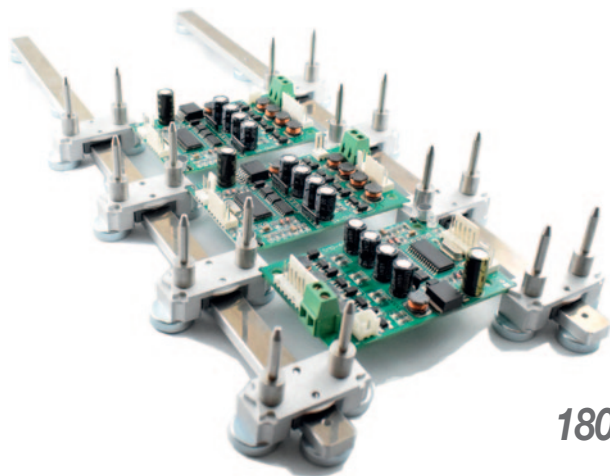


INHALT

November 2018



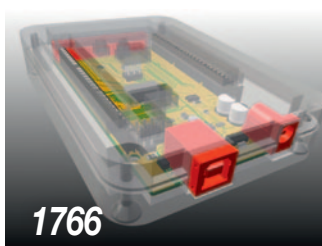
1803

Mit Low-pressure-Jetting kann Epsys die Umrüstzeiten von Beschichtungsanlagen verkürzen, ohne Kompromisse bei der Qualität eingehen zu müssen. Im Angebot des Maschinenentwicklers sind auch jede Menge aus der Praxis geborene Zubehörteile



1758

Neuer Lösungsansatz: Erste Fachkonferenz ‚Technische Sauberkeit‘ des ZVEI



1766

Version 10.0 des EDA-Tools Pulsonix bietet neue Bearbeitungsmöglichkeiten in 3D



1791

Häusermann ist jetzt KSG Austria. Anlass für PLUS, Margret Gleiniger zu interviewen

EDITORIAL

Traceability statt Trial & Error 1729

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes 1733

Electronica 2018: Schwerpunkt Medical Electronics 1743

Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 1754

Neue Normen 1757

BAUELEMENTE

Technische Sauberkeit – Funktionssicherheit ist das Ziel 1760

DESIGN

Fertigungsgerechtes PCB-Design in Echtzeit 1764

DESIGN

Neue 3D PCB-Design-Fähigkeiten 1768

Aufs Siebertreppchen beim TT-Zero-Cup 1770

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrichkeit):
Sind wir in Europa auf ‚Zu-spät-kommen‘ abonniert? 1778

Dyconex auf Automatisierungskurs 1784

Positiv gestimmt Richtung 2019 1791

„Wiederbelebung der Marke heißt, auf Anforderungen
der Zukunft mit den richtigen Konzepten reagieren“ 1795

BAUGRUPPEN & SYSTEME

Flexibel Lackieren mit Low-Pressure Jetting 1803



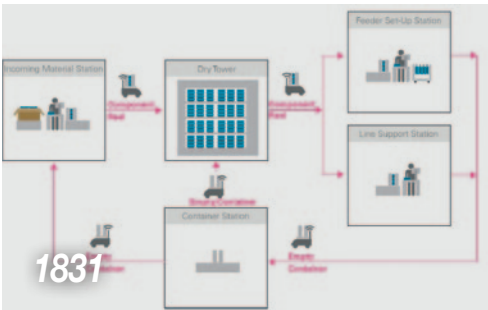
ventec
INTERNATIONAL GROUP
騰輝電子

*Flexible, zuverlässige
Supply-Chain-Lösungen
Qualitative hochwertige
Basismaterialien
und Prepregs*



1822

Qualität beweisen: Die Simulation großer Höhen in der Altitude-Kammer gehört zu den vielen Möglichkeiten von TechnoLab



1831

IoT und I4.0 in der Vernetzung von Elektronik-Fertigungslinien: ASYS zeigt den Weg in Richtung Smart Factory



BAUGRUPPEN & SYSTEME

Thermosonisches Drahtbonds auf galvanisch abgeschiedenen Oberflächen – Teil 2	1806
Wärmeleitende und elektrisch isolierende Epoxidharz-Klebstoffe	1816
Leiterplattenkonstruktion und Fertigungskosten senken	1816
Neue Fertigungsverfahren für mehr Kühlleistung	1817

ANALYTIK & TEST

Präventive Umweltsimulation und Schadensanalytik sichern Qualität und Zuverlässigkeit	1822
---	------

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Intelligent Factory in der Elektronikindustrie	1831
Patente	1835

PLUS 11/2018 | 1731

Ventec ist Spezialist für die Herstellung von hochwertigen Basismaterialien und Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz liefert kundenspezifische Supply-Chain-Lösungen in alle Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren in China, Großbritannien, Deutschland und den USA ist niemand besser positioniert, um die Bedürfnisse der globalen Leiterplattenindustrie zu bedienen.

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact@ventec-europe.com

T: Follow @VentecLaminates

www.ventecclaminates.com



1846

Wie setzt man eine hochmoderne Supply-chain auf? Antworten auf diese Frage gibt Andreas Frank (TQU Group)

FORUM

Systemintegration elektronischer Systeme – Technologien für die Zukunft	1838
Gestaltung eines hochmodernen Supply Chain Systems	1846
Trumps China-Politik zeigt negative Wirkung auf Taiwan	1849
Kolumne: Hellsehen	1851
PLUS-Firmenverzeichnis	1854
Im Heft redaktionell erwähnte Firmen	1881
Stellenmarkt	1883
Inserentenindex	1884
Mediadaten	1885
Impressum	1887
Produkt des Monats	1888

Titelbild

Das neueste OrCAD / Allegro Release (QIR7) liefert zahlreiche neue Features.

Ausführliche Informationen zur neuen Art PCBs zu designen, erhalten Sie in München auf der electronica, am Messestand von FlowCad: Halle A3, Nr. 616.

info@FlowCAD.de
Tel. +49 89 4563-7770

Die Fachzeitschrift PLUS ist das Organ folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente
Distribution e.V.
Tel. +49 8563 9788908
a.falke@fbdi.de, www.fbdi.de

1762



Fachverband Elektronik-Design e.V.
Tel. +49 30 340 60 30 50
info@fed.de, www.fed.de

1772



EIPC – Der Europäische
Elektronik-Verband
Tel. +31 46 4264258
www.eipc.org

1782



Fachverband Electronic
Components and Systems
Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

1799



Fachverband PCB
and Electronic Systems
Tel. +49 69 6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS
AND PACKAGING SOCIETY –
Deutschland e.V.
Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

1818



Forschungsvereinigung
Räumliche Elektronische
Baugruppen 3-D MID e.V.
Tel. +49 911 5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de

1828



DVS – Deutscher Verband
für Schweißen und
verwandte Verfahren e.V.
Tel. +49 211 1591-0
michael.weinreich@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

1836